

MEMS研究開発拠点 装置一覧

2025年6月1日現在

No.	装置番号	施設等名称	備考		
			試料寸法	設置場所	用途
1	MEMS001	ウェハディップ洗浄装置	200mm/300mm	TKB812-F	処理
2	MEMS002	ウェハスピン洗浄装置	200mm/300mm	TKB812-F	処理
3	MEMS003	有機ドラフト	300mm 以下	TKB812-F	処理
4	MEMS004	異方性ウェットエッチング装置	200mm	TKB812-F	加工
5	MEMS005	IPA ベーパー乾燥機	200mm	TKB812-F	処理
6	MEMS006	i-線ステッパ	200mm	TKB812-F	加工
7	MEMS007	マスク露光装置	200mm	TKB812-F	加工
8	MEMS008	マスクレス露光装置	500mm 角以下	TKB812-F	加工
9	MEMS010	光学顕微鏡	300mm 以下	TKB812-F	分析・評価
10	MEMS011	Si 酸化膜プラズマCVD 装置	200mm/300mm	TKB812-F	加工
11	MEMS012	スパッタ	200mm	TKB812-B	加工
12	MEMS013	酸化炉	200mm	TKB812-F	加工
13	MEMS015	Si 窒化膜減圧CVD 装置	200mm	TKB812-F	加工
14	MEMS016	ポリ Si 減圧 CVD 装置	200mm	TKB812-F	加工
15	MEMS017	金属膜ドライエッチング装置	200mm	TKB812-F	加工
16	MEMS018	Si 酸化膜ドライエッチング装置	200mm	TKB812-F	加工
17	MEMS019	8 ¹⁶ Si 深掘ドライエッチング装置	200mm	TKB812-F	加工
18	MEMS020	12 ¹⁶ Si 深掘ドライエッチング装置	300mm	TKB812-F	加工
19	MEMS021	犠牲層ドライエッチング装置	100/150/200mm	TKB812-F	加工
20	MEMS022	アッシャー	300 mm以下	TKB812-F	加工
21	MEMS023	光学検査顕微鏡	200mm 以下	TKB812-F	分析・評価
22	MEMS024	段差測定器	200mm 以下	TKB812-F	分析・評価
23	MEMS025	エリブソメーター	200mm 以下	TKB812-F	分析・評価
24	MEMS026	膜厚測定器	200mm 以下	TKB812-F	分析・評価
25	MEMS027	ウェハ塵埃検査装置	200 mm	TKB812-F	分析・評価
26	MEMS028	干渉型表面形状評価装置	200mm 以下	TKB812-F	分析・評価
27	MEMS029	シート抵抗プローバー	200mm 以下	TKB812-F	分析・評価
28	MEMS030	赤外線レーザ顕微鏡	200mm 以下	TKB812-F	分析・評価
29	MEMS031	レーザ顕微鏡	200mm 以下	TKB812-F	分析・評価
30	MEMS032	ブレードダイサー	300mm 以下	2A-CR	加工
31	MEMS033	レーザステルスダイサー	200mm 以下	2A-CR	加工
32	MEMS034	光学顕微鏡	300mm 以下	2A-CR	分析・評価
33	MEMS036	電子ビーム/抵抗蒸着装置	200 mm	TKB812-B	加工
34	MEMS037	熱処理装置	200mm	TKB812-B	加工
35	MEMS038	チップ to ウェハ接合装置	100/150/200/300mm	TKB812-B	加工
36	MEMS039	ウェハ to ウェハ接合装置	100/150/200mm	TKB812-B	加工
37	MEMS041	光表面処理装置	200mm	TKB812-B	処理
38	MEMS042	12 ¹⁶ ウェハ常温接合装置	100/150/200/300mm	3F-CR	加工
39	MEMS043	測長 SEM	200mm	TKB812-B	分析・評価

40	MEMS044	分析 SEM	300 mm以下	TKB812-B	分析・評価
41	MEMS045	超音波顕微鏡	300mm 以下	TKB812-B	分析・評価
42	MEMS046	赤外線顕微鏡	200mm 以下	TKB812-B	分析・評価
43	MEMS047	薄膜応力評価装置	100/125/150/200 mm	TKB812-B	分析・評価
44	MEMS048	X 線 CT 評価装置	300 mm以下	TKB812-B	分析・評価
45	MEMS049	テスタープローバー	200mm 以下	TKB812-B	分析・評価
46	MEMS050	光学顕微鏡	300mm 以下	TKB812-B	分析・評価
47	MEMS051	圧電定数評価装置	100-200mm	3H-CR	分析・評価
48	MEMS053	ダイシエータスタ	100mm 以下	TKB812-B	分析・評価
49	MEMS058	無機ドラフト	300mm 以下	TKB812-F	処理
50	MEMS059	レジスト塗布現像装置	200 mm	TKB812-F	分析・評価
51	MEMS060	イオンミリング装置	200mm 以下	TKB812-B	加工
52	MEMS069	自動光学顕微鏡	200mm 以下	TKB812-F	分析・評価
53	MEMS071	フーリエ変換赤外分光装置	200mm 以下	TKB812-F	分析・評価
54	MEMS072	小口径スパッタ	100mm 以下	TKB812-B	分析・評価
55	MEMS073	マニュアルプローバ	200mm 以下	TKB812-B	分析・評価
56	MEMS074	ダイシングフィルム貼付装置	200mm 以下	2A-CR	加工
57	MEMS075	保護フィルム貼付装置	200mm 以下	TKB812-F	加工
58	MEMS076	フォトリソ工程用オープン	200mm 以下	TKB812-F	加工
59	MEMS077	2流体洗浄装置	200mm 以下	3F-CR	処理
60	MEMS078	リフトオフ装置	200mm 以下	TKB812-F	加工
61	MEMS079	レーザーマーカ	200mm 以下	TKB812-F	処理
62	MEMS080	チップソーター	200 mm以下	TKB812-B	加工
63	MEMS081	高速シリコン深掘り装置	200 mm以下	2E-CR	加工
64	MEMS082	高速酸化膜ICPエッチング装置	200 mm以下	2E-CR	加工
65	MEMS083	金属膜ICPエッチング装置	200 mm以下	2E-CR	加工
66	MEMS084	汎用RIE装置	200 mm以下	2E-CR	加工
67	MEMS085	低温対応酸化膜・窒化膜CVD装置	200 mm以下	2E-CR	加工
68	MEMS086	高荷重フリップチップボンダー	100 mm角以下	2E-CR	加工
69	MEMS087	ピコ秒レーザー加工機	200 mm角以下	2E-CR	加工
70	MEMS088	イナートオープン	200 mm角以下	2E-CR	処理
71	MEMS089	酸素プラズマバレル型アッシャー	150 mm以下	2E-CR	加工
72	MEMS090	水蒸気プラズマ対応アッシャー	200 mm角以下	2E-CR	加工
73	MEMS091	両面スクラブ・二流体・メガソニックウエハ洗浄装置	200 mm以下	2E-CR	処理
74	MEMS092	高解像度4Kデジタルマイクロスコープ	300 mm以下	2E-CR	分析・評価
75	MEMS093	裏面対応高速レーザー直描装置	200 mm角以下	2E-CR	加工
76	MEMS094	裏面対応コンタクトアライナ	100 mm以下	2E-CR	加工
77	MEMS095	青色レーザー顕微鏡	300 mm以下	2E-CR	分析・評価
78	MEMS096	セミオートコーター・デベロッパ	200 mm以下	2E-CR	加工
79	MEMS097	HMDs処理装置	200 mm以下	2E-CR	処理
80	MEMS098	スプレーコーター	200 mm角以下	2E-CR	加工
81	MEMS099	光学干渉式膜厚計	300 mm以下	2E-CR	分析・評価

82	MEMS100	触診式段差計	100 mm以下	2E-CR	分析・評価
83	MEMS101	電界放出形電子顕微鏡	100 mm以下	2E-CR	分析・評価
84	MEMS102	冷却イオンミリング装置	小片	2E-CR	加工
85	MEMS103	オスミウムコーター	100 mm以下	2E-CR	加工
86	MEMS104	マニュアルへき開装置	200 mm以下	2E-CR	加工
87	MEMS105	赤外線顕微鏡	100 mm以下	2E-CR	分析・評価
88	MEMS106	マニュアルボールボンダー	小片	2E-CR	加工
89	MEMS107	マニュアルウェッジワイヤーボンダー	小片	2E-CR	加工
90	MEMS108	マニュアルダイボンダー	小片	2E-CR	加工
91	MEMS109	25MHz3次元レーザードップラー振動計	200 mm角以下	2E-CR	分析・評価
92	MEMS110	白色干渉式形状観察装置	200 mm角以下	2E-CR	分析・評価
93	MEMS111	半導体パラメータアナライザ	—	2E-CR	分析・評価